

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Semiconductor Manufacturing International Corporation

中芯國際集成電路製造有限公司*

(於開曼群島註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：981)

海外監管公告

**關於擬將美國預托證券股份從紐約證券交易所退市
和撤銷根據美國證券交易法之註冊及終止申報責任之公告**

中芯國際集成電路製造有限公司(「中芯國際」或「本公司」)；紐約證券交易所：SMI；香港聯合交易所：981)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.10B條作此公告。

中芯國際今日宣佈，本公司已於二零一九年五月二十四日(美國東部時間)通知紐約證券交易所(「紐約證券交易所」)，本公司將根據一九三四年美國證券交易法(經修訂)(「交易法」)申請自願將其美國預托證券股份(「美國預托證券股份」)從紐約證券交易所退市，並撤銷該等美國預托證券股份和相關普通股的註冊。出於一些考慮因素，包括中芯國際美國預托證券股份的交易量與其全球交易量相比有限，以及為維持美國預托證券股份在紐約證券交易所上市及在美國證券交易委員會(「美國證交會」)註冊並遵守交易法的定期報告和相關義務中所涉及的重大行政負擔和成本，中芯國際董事會批准將其美國預托證券股份從紐約證券交易所退市，並根據交易法撤銷該等美國預托證券股份和相關普通股的註冊。

因此，中芯國際擬於二零一九年六月三日或前後向美國證交會提交表格25，將其美國預托證券股份從紐約證券交易所退市。將美國預托證券股份從紐約證券交易所退市一事，預期將於提交表格25後十日生效。美國預托證券股份在紐約證券交易所交易的最後日期為二零一九年六月十三日或前後。於該日期及自該日期之後，中芯國際的美國預托證券股份(以美國預托收據(「美國預托收據」)為憑證)將不再於紐約證券交易所上市。

一旦退市生效並且中芯國際已達到撤銷註冊的條件，中芯國際擬於二零一九年六月十四日或前後向美國證交會提交表格15F，以根據交易法撤銷其美國預托證券股份和相關普通股的註冊。此後，中芯國際根據交易法承擔的所有申報責任將暫停，除非表格15F隨後遭撤回或拒絕。根據交易法撤銷中芯國際在美國證交會的註冊和終止其申報責任，預計將在向美國證交會提交表格15F後90天生效。提交表格15F後，中芯國際將在其網站www.smics.com上公佈交易法第12g3-2(b)條要求的信息。中芯國際亦將根據上市規則，繼續遵守其作為上市發行人的財務報告及其他責任。

在將其美國預托證券股份從紐約證券交易所退市後，中芯國際仍然致力於為其投資者服務，並有意將其美國預托收據計劃維持為一級計劃，這將使美國投資者和中芯國際美國預托證券股份的現有持有人能夠繼續持有中芯國際美國預托證券股份，和在美國場外交易市場進行交易。因應美國預托證券股份退市，中芯國際證券的交易將集中在中芯國際的一級市場(即香港聯合交易所有限公司)進行。

在上述提交生效之前，中芯國際保留其延遲或撤回上述提交的所有方面權利，如有需要，亦將根據上市規則或其他適用法律發佈任何進一步公告。

關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司(「中芯國際」；紐約證券交易所：SMI；香港聯合交易所：981)，是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地技術最全面、配套最完善、規模最大、跨國經營的集成電路製造企業，提供0.35微米到28納米不同技術節點的晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於中國上海，擁有全球化的製造和服務基地。在上海建有一座300mm晶圓廠和一座200mm晶圓廠；在北京建有一座300mm晶圓廠和一座控股的300mm先進制程晶圓廠；在天津和深圳各建有一座200mm晶圓廠；在江陰有一座控股的300mm凸塊加工合資廠；在意大利有一座控股的200mm晶圓廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本和台灣地區設立行銷辦事處、提供客戶服務，同時在香港設立了代表處。

就一九九五年私人有價證券訴訟改革法案作出的「安全港」提示聲明

本公告可能載有(除歷史資料外)依據一九九五年美國私人有價證券訴訟改革法案以及一九三三年美國證券法第27A條及一九三四年美國證券交易法第21條E的「安全港」條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述乃基於中芯國際對未來事件的現行假設、期望及預測。中芯國際使用「相信」、「預期」、「計劃」、「估計」、「預計」、「預測」及類似表述為該等前瞻性陳述之標識，但並非所有前瞻性陳述均包含上述字眼。該等前瞻性陳述乃反映中芯國際高級管理層根據判斷作出的估計，存在重大已知及未知的風險、不確定性以及其他可能導致中芯國際實際業績、財務狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料有重大差異的因素，包括(但不限於)與半導體行業週期及市況有關風險、激烈競爭、中芯國際客戶能否及時接受晶圓產品、壞帳風險、能否及時引進新技術、中芯國際量產新產品的能力、半導體代工服務供求情況、行業產能過剩、設備、零件及原材料短缺、製造產能供給和終端市場的金融情況是否穩定。

除法律規定者外，中芯國際概不對因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況承擔任何責任，亦不擬更新前瞻性陳述。

詳細資訊請參考中芯國際網站www.smics.com。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
高永崗博士
執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書

中國上海，二零一九年五月二十四日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

周子學 (董事長)

趙海軍 (聯合首席執行官)

梁孟松 (聯合首席執行官)

高永崗 (首席財務官兼聯席公司秘書)

非執行董事

陳山枝

周杰

任凱

路軍

童國華

獨立非執行董事

William Tudor BROWN

蔣尚義

叢京生

劉遵義

范仁達

* 僅供識別